



Advanced Packaging Conference

Auch in diesem Jahr findet wieder die von SEMI und IMAPS Europe während der SEMICON gemeinsam veranstaltete *Advanced Packaging Conference* statt, deren Zeitplan nunmehr vorliegt:

Advanced Packaging Conference in conjunction with SEMICON Europe 2006

Tuesday 4 April 2006, 9:30 – 17:20, ICM – International Congress Center Munich, Germany

Wafer Level Packaging and Beyond: from samples to volumes

This conference will address new packaging technology trends and their impact on manufacturing and supply chain.

09.30 – 09.35 Welcome and Opening Remarks

09.35 – 10:15 Keynote speech by Kari Kulojärvi,
Director, Mechanics and Miniaturization, Nokia

Confirmed speakers:

- *Stacked Silicon Module Approach to System-in-Package*
Charles J. Vath, III, ASM Technology Singapore
- *Plasma Surface Modification Technology for Flip-chip Package*
Masaru Nonomura, Panasonic
- *IMB Technology for Embedding Active Components into a Substrate*
Risto Tuominen, Imbera, Finland
- STMicroelectronics
Speaker invited
- IMEC
Speaker invited
- *TULIP a new platform for leadless semiconductor packages*
Wil Peels, Philips Semiconductors
- *Design and Fabrication of Integrated Passives in Thin Film Technology – An Overview*
Kai Zoschke, Fraunhofer IZM
- *Taking Wafer Level Packaging to the Next Stage: A 200 mm Silicon Technology Compatible Embedded Device Technology*
Edward Fürgut, Infineon Technologies
- *Novel Wafer Level Chip on Board Technology Enables Higher Yields and Reduced Costs for Optical Devices*
Yehudit Dagan, Tessera
- *Ultra-Thin Wafer Processing and Wafer-Level Transfer utilizing Temporary Bonding and Die Bonding Technology*
Stefan Pargfrieder, EV Group

Organized by



In collaboration with



Programs Committee

Jens Mueller, Committee Chairman, IMAPS
 Carlo Cognetti, STMicroelectronics
 Dietrich Toennies, Suss MicroTec
 Klaus Pressel, Infineon
 Andy Longford, Panda Europe
 Rolf Aschenbrenner, FhG-IZM
 Eric Beyne, IMEC

Who should attend

This conference is designed for Advanced Packaging experts, Manufacturing and R&D counterparts and the key representatives of Packaging Equipment and Service Companies.

Price

Before 3th March 2006 – SEMI-Member 230,- € / Non-Member 260,- €
 After 3th March 2006 – 280,- €
 (includes paper proceedings, coffee breaks, lunch)
 Auch für IMAPS-Mitglieder gilt bis zum 3. März ein reduzierter Preis für die Teilnahme!

Internationales Wissenschaftliches Kolloquium an der TU Ilmenau

Die Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der *TU Ilmenau* richtet in der Zeit vom 11. bis 15. September das *51. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium der TU Ilmenau* aus. Diese wissenschaftliche Konferenz der *TU Ilmenau* hat eine lange Tradition und findet jährlich statt, wobei sich die Fakultäten bei der Ausrichtung abwechseln. Das Leitmotiv der Konferenz für 2006 lautet:

Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technologies for the Future

Das wissenschaftliche Programm der Tagung wird sich auf die folgenden Schwerpunkte konzentrieren:

- Multimedia Communications
- Wireless Communication Systems and Sensor Technologies
- Applied Electromagnetics and Circuit Theory
- Micro- and Nanoelectronics
- Functional Electrical and Electronic Materials and Devices
- Power Engineering
- Electro-Processing Technologies

Während der Tagung wird eine Reihe spezieller und zusätzlicher Veranstaltungen durchgeführt.

Am Donnerstag, dem 14. September 2006, findet ab 13:00 Uhr ein öffentlicher Workshop mit Abschlusspräsentationen zum Forschungsprojekt *Keramische Mikro-*

wellenschaltungen für die Satellitentechnik (KERAMIS) statt. Dieses Projekt wurde von BMBF und DLR gefördert.

Am 13. und 14. September veranstaltet die Nachwuchsforschergruppe *Funktionalisierte Peripherik des Zentrums für Innovationskompetenz MacroNano®* ein Kolloquium mit etwa 16 Vorträgen zum Thema *LTCC RF-and Microsystem Interconnect*.

Darüber hinaus finden ein Workshop zum Thema *Digitaler Rundfunk* sowie am 14. und 15. September der *10th Multimedia for Education and Business Workshop* statt.

Weitere Informationen und Vortragsanmeldungen

Technische Universität Ilmenau, Referat Marketing und Studentische Angelegenheiten / Kongressorganisation, Andrea Schneider, Postfach 100565, 98684 Ilmenau, Tel. +49/3677/69-2520, Fax -1743, kongressorganisation@tu-ilmenau.de, www.iwk.tu-ilmenau.de

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2005*, das am 10. Februar 2005 in Göppingen zum Thema *Hochtemperaturelektronik* stattfand, können noch auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2005*, die am 10. und 11. Oktober 2005 in München durchgeführt wurde, sind als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.*

Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

ZMN – Außenstelle Haus M

Am Helmholtzring 1

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3380

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Egerlandstraße 88

D-73431 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik

Schatzmeister

c/o FH Rosenheim

Hochschulstraße 1

D-83024 Rosenheim

Fon: 08031/805-629

Fax: 08031/805-603

e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden

FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden

Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499

e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und

Mikrointegration

Chip Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25

D-13355 Berlin

Fon: 030/46403-164

Fax: 030/46403-161

e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Min. Franz Bechtold

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VIA electronic GmbH

Robert-Friese Straße 3

D-07629 Hermsdorf

Fon: 036601/81-529

Fax: 036601/81-530

e-mail: franz.bechtold@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Rheinstraße 10 B

D-14513 Teltow

Fon: 03328/435-242

Fax: 03328/435-256

e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe

Öffentlichkeitsarbeit

c/o TU Ilmenau

Fakultät EI

FG Mikroperipherik

Pf 100565

D-98684 Ilmenau

Fon: 03677/69-3429

Fax: 03677/69-3350

e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH

Klein Grötzing

D-84494 Neumarkt-St. Veit

Fon: 08722/9620-0

Fax: 08722/9620-30

e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter

Öffentlichkeitsarbeit

c/o FHTE Standort Göppingen

Robert-Bosch-Str. 1

D-73037 Göppingen

Fon: 07161/679-157

Fax: 07161/679-233

e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann

Öffentlichkeitsarbeit

EADS Deutschland GmbH

Microwave Factory / Defence Electronics

Woerthstr. 85

D-89077 Ulm

Fon: 0731/392-3879

Fax: 0731/392-3362

e-mail: martin.oppermann@imaps.de